



NAS 有限会社NAS技研
GIKEN

高度な技術力で 微量分析をサポート

Perfect Support of Wafers Analysis

世界に誇る 表面汚染回収装置の 専門メーカー

World-Class Professional Manufacturer of
Wafer Surface Contamination Recovery Devices

ごあいさつ GREETING

常に新しい視野で挑戦し続けます

We continuously challenge with a new perspective.

私たちが日常生活で使っているスマートフォン・テレビ・エアコン・自動車・電車などの、ほとんどの電化製品や交通機関を動かすために、半導体デバイスが使われております。この半導体デバイスの基板材料となるのが「シリコンウェーハ」です。ウェーハの表面には、微量の金属汚染物質が付着していることがあります。汚染が付着したウェーハを使って半導体を製造すると、性能や信頼性に悪影響を及ぼします。このウェーハの品質を検査するために、表面の汚染を回収して分析する必要があります。当社は2002年の設立以来、半導体産業に必要不可欠なウェーハの品質検査のため、表面に付着している微量の汚染物質を回収する装置の開発・製造・販売を行ってきました。

Semiconductor devices are used to control most of the electrical appliances and transportation in our daily lives, such as smartphones, TV, air conditioners, cars and trains. The substrate material for the semiconductor devices is "silicon wafer". The silicon wafers surfaces may have nano traces of metallic contaminants. Production of semiconductor using contaminated wafers adversely affect performance and reliability. To check their quality, the surfaces contamination must be sampled and analyzed.

Since our establishment in 2002, we have been developing, manufacturing and selling equipment that collect metal contaminants of wafers surfaces, which is indispensable for the semiconductor industry.



有限会社NAS技研

取締役 櫻井 信夫

NAS Giken, Inc.

CEO NOBUO SAKURAI

取得特許 PATENT



NAS技研は、シリコンウェーハの表面汚染回収とバルクエッチング機能を提供する専門メーカーです。

現場の課題を迅速に把握し、お客様からの様々なニーズにお応えしてきました。

We have addressed various demands of customers for decontamination of silicon wafers surfaces and for bulk etching function. Our extensive product enables to satisfy the most sophisticated technological demands of semiconductor industry.

優れた バルクエッチング 機能

The Highest Quality
of Bulk Etching Function

1 「バルクエッチング」によりウェーハの表面全体を削り、内部の汚染物質を回収することができます。当社のバルクエッチングの性能は非常に優れ、10%以内の平坦度を保証しております。

“Bulk etching” allows etching process of the entire wafers surfaces and results in the collection of internal contaminants. Our etching performance can guarantee flatness within 10% and have satisfied various customers up to now.

世界 トップクラスの 汚染回収機能

World-Class Wafers Contamination
Recovery System

2 シリコンウェーハ側面の汚染回収操作である「ベベル回収」において国際特許を取得しています。親水面ウェーハの回収においても国内特許を取得し、世界トップクラスの機能性と技術力に誇りをもっています。

We have obtained an international patent for “bevel recovery,” which is a contamination recovery operation on the side of a silicon wafer. Also, we have granted a domestic patent regarding to sampling hydrophilic wafer surfaces. Our technology stands for uncompromising quality and precision all over the world.

NAS技研の特徴 FEATURES

万全な アフターサービス

Perfect After-Sales Service

3 当社製品のメンテナンスは、海外・日本全国に対応しています。故障などで詳細を確認する場合、原則48時間以内に訪問・電話・メール・ウェブ会議にて対応いたします。製品のメンテナンス期限はありませんので、長期間安心して当社装置をご使用いただけます。

We provide maintenance service both all over Japan and overseas customers. Our sales support shall respond to customer inquiries from Japan in within 24 hours (overseas less than 48 hours). When confirming maintenance details, we may visit your site, hold telephone or online conferences with as appropriate.

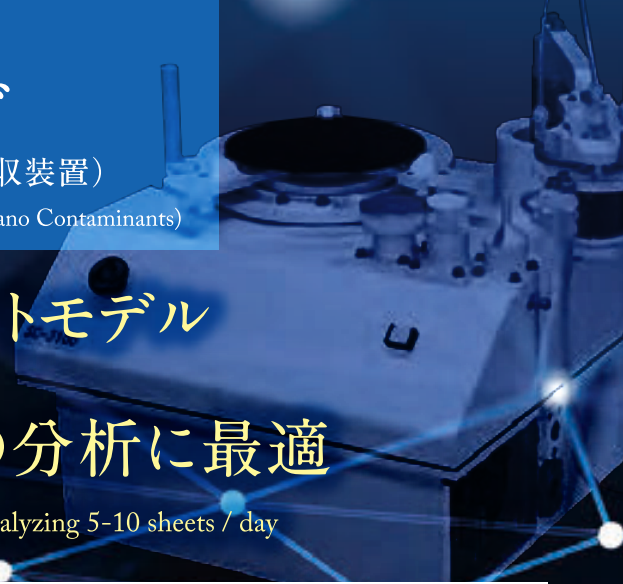
SCシリーズ

(簡易型微量金属汚染物質回収装置)

SC Series (Semi-Automated Recovery System of Nano Contaminants)

世界唯一のコンパクトモデル & 1日あたり5~10枚程度の分析に最適

Only Compact Model in the World & Perfect for Analyzing 5-10 sheets / day



	SC-3100	SC-8100	SC-9100
装置名 Device Name	  		
操作 Operation	パソコン※3 PC *3		
保持具の装着 / 脱着 Attaching / Detaching Liquid Holders	自動 Auto	手動 Manual	自動 Auto
サンプリング用薬液の供給 Supply of Liquid for Sampling	自動 Auto	手動 Manual	自動 Auto
サンプリング用薬液の回収 Collection of Liquid for Sampling	自動※1 Auto *1	手動 Manual	自動 Auto
基本回収パターン Basic Sampling Pattern	リング状、扇形、固定、半径、円弧 Ring-shaped, Fan-shaped, Fixed, Radius, Arc		
追加回収パターン※1 Additional Sampling Pattern *1	側面、矩形、弓形 Side (Bevel), Rectangle, Circular Segment		
オリフラ処理※2 Orientation Flat *2	リング状、固定半径、側面の回収パターンに付加 Ring-shaped, Fixed Radius, Side (Bevel)		
吸い上げ式液回収 Sucking-Up Type Collection of Liquid	○	—	○
親水面の回収 Sampling of Hydrophilic Surface	—	○	○
外形(W×D×H) (mm) Size (W×D×H) mm	630×550×600	600×550×700	630×550×790
重量 Weight	35Kg	40Kg	50Kg
使用場所 Recommended Environment	クリーンドラフト内 Inside Clean Draft		
必要ユーティリティ Utilities	電源 (AC100-240V)、 純水、クリーンドライエア AC-100-240V, DIW, CDA	電源 (AC100-240V)、 N2、クリーンドライエア AC-100-240V, N2, CDA	電源 (AC100-240V)、 純水、N2、クリーンドライエア AC-100-240V, DIW, N2, CDA

NACシリーズ

(微量金属汚染物質自動回収装置)

NAC Series (Automated Recovery System of Nano Contaminants)

特許技術を活かした親水面ウェーハの回収 & 高性能なバルクエッチング機能

Sampling Hydrophilic Wafers Surface Utilizing Patented Technology
& High-Quality Performance of Bulk Etching

	NAC-302	NAC-304	NAC-316
装置名 Device Name			
対応ウェーハサイズ Wafer Size	125mm、150mm、 200mm、300mm	125mm、150mm、 200mm、300mm	300mm
操作 Operation	本体備え付けのパソコン PC		
バルクエッチング機能 Bulk Etching Function	—	○	○
ICP-MS自動接続機能 ICP-MS Auto Connection	—	—	○
ICP-MS検量線自動調整機能 Automatic Preparation of ICP-MS Calibration Curve	—	—	○
ロードポート対応 Load Port	—	—	○
基本回収パターン Basic Sampling Pattern	リング状、固定半径、側面 Ring-shaped, Fixed Radius, Side (Bevel)		
外形(W×D×H) (mm) ^{*1} Size (W×D×H) mm ^{*1}	1850×1350×2000	2000×1500×2000	1700×2800×2300
使用設備 Equipment Used	酸排水、一般排気、酸排気 Acid Drainage, General Exhaust, Acid Exhaust		
使用場所 Recommended Environment	クリーンルーム内 Inside Clean Room		
必要ユーティリティ Utilities	電源(AC100V 15A)、 純水、N2、クリーンドライエア AC100V 15A, DIW, N2, CDA	電源(AC100V 15A)、 純水、O2、N2、クリーンドライエア AC100V 15A, DIW, O2, N2, CDA	

会社概要

COMPANY PROFILE

会社名 Company Name	有限会社NAS技研 NAS Giken, Inc.
本社 Headquarters	〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 36-7 36-7 Higashimatsubara, Hakonegasaki, Mizuho-machi, Nishitama-gun, Tokyo 190-1222
創業 Founded	2002年10月25日 25, October, 2002
資本金 Share Capital	300万円 3,000,000 JPY
事業内容 Business	シリコンウェーハ表面・側面の金属汚染回収装置、バルクエッチング装置の製造販売 Produce devices of both sampling metal contamination on surfaces & bevels of wafers and bulk etching.
職員数 Number of Employees	正社員12名 12 (Permanent)
主な取引先 Customers	国内の主要半導体メーカー、デバイス(半導体関連機器)メーカー、分析メーカー Major Wafers manufacturers, device and analysis companies in the semiconductor industry.



<https://www.nasgiken.jp/>

お問い合わせ

お電話
TEL 042-557-5207

受付時間 9:00 - 17:00

メールフォーム
MAIL FORM

